

关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）簿记建档时间的公告

厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕3138 号”文注册。

根据《厦门金圆投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人定于 2024 年 4 月 23 日 15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。

因簿记建档当日部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 4 月 23 日 18:00 延长至 2024 年 4 月 23 日 19:00。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（数字经济）（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

厦门金圆投资集团有限公司

2024 年 4 月 23 日



（此页无正文，为《关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）



（此页无正文，为《关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人工智能公司债券（数字经济）（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

金圆统一证券有限公司

2024 年 4 月 23 日

（此页无正文，为《关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）



（此页无正文，为《关于延长厦门金圆投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（数字经济）（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）

